

In questi mesi si inseguono notizie e rumors circa le nuove feature che saranno offerte da **Intel Ivy Bridge**

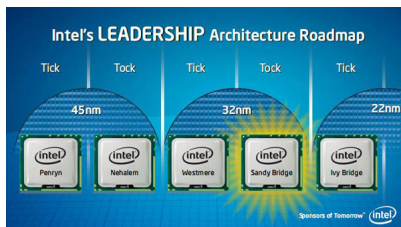
, l'evoluzione a **22 nanometri**

dell'attuale architettura per processori Intel Sandy Bridge, che sarà [presentata al Computex di Taipei](#)

che si terrà il prossimo giugno. E' interessante analizzare queste novità in quanto, come già sappiamo, la futura piattaforma per notebook

**Intel Chief River**

, che sostituirà l'attuale Huron River, supporterà proprio le CPU basate su architettura Ivy Bridge.



Come più diffusamente riportato nelle nostre due precedenti notizie ([qui](#) e [qui](#)), sostanzialmente pare che, oltre al passaggio al nuovo processo produttivo a 22 nm, le novità riguarderanno l'introduzione del supporto nativo allo

**standard USB 3.0**

, la presenza di un controller per memorie

**DDR3 da 1.600 MHz**

e della tecnologia

**HDMI 1.4.**

Ma soprattutto in primo piano sono le indiscrezioni che riguardano le nuove performance dell'IGP integrato. Il nuovo sottosistema grafico infatti supporterà le

**DirectX 11**

(mentre l'attuale è fermo alle 10.1), ma soprattutto avrà

**24 unità di elaborazione**

, ossia il doppio rispetto alla generazione attuale.

E' di oggi inoltre la notizia che, stando ad alcune slide pubblicate dal sito [Semi-Accurate](#), **Ivy Bridge supporterà anche PCI Express 3.0**

. Questo standard, molto più performante, prevede un nuovo schema di

### **codifica 128b/130b**

(contro l'attuale 8b/10b) e un'ampiezza di banda del bus che raggiunge gli

### **8 GT/s**

, il doppio rispetto agli attuali. In realtà, infatti, PCI Express 2.0 offre 5 GT/s di bus, ma a questi bisogna sottrarre circa il 20% di prestazioni, proprio a causa del modello di encoding, che provoca un notevole overhead, con risultato che la bandwidth realmente disponibile ammonta a circa 4Gb/s.

Nel nuovo standard invece il passaggio al nuovo schema di codifica permette di ottenere una **b**

### **anda passante di 8 Gb/s**

, che è quindi esattamente doppia. Si prospetta quindi un

### **autunno caldo**

con nuovi e performanti prodotti del mondo mobile e una guerra accesa tra queste soluzioni Intel e quelle proposte da

### **AMD e NVIDIA**

. Se tutte le voci fossero confermate, le prestazioni offerte dalla

### **piattaforma Chief River**

sarebbero superiori a quelle attualmente presenti sul mercato. Dal canto suo AMD dovrebbe rispondere integrando lo standard USB 3.0 nella sua piattaforma Brazos, basata su chipset Hudson D1 ed APU (Accelerated Processing Unit) Ontario.